证券代码：688432　　证券简称：有研硅

有研半导体硅材料股份公司 2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	265,941,620.34	2.40	773,102,420.66	-2.18
归属于上市公司股东的净利润	64,198,280.33	5.69	194,681,391.43	-12.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,723,652.45	42.24	144,071,369.89	-5.13
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	143,440,696.32	-40.76
基本每股收益(元/股)	0.05	5.86	0.16	-12.20
稀释每股收益(元/股)	0.05	5.86	0.16	-12.20
加权平均净资产收益率(%)	1.51	增加0.05个百分点	4.62	减少0.82个百分点
研发投入合计	15,722,685.49	-28.53	58,800,004.10	-10.20
研发投入占营业收入的比例(%)	5.91	减少2.56个百分点	7.61	减少0.68个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,246,749,661.06	5,043,056,336.86		4.04
归属于上市公司股东的所有者权益	4,296,496,795.46	4,147,998,364.82		3.58

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-7,672.81	14,256.59	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	7,345,880.51	35,827,907.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	7,389,195.22	30,088,660.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,865.91	79,692.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	1,948,931.60	8,571,309.70	
少数股东权益影响额（税后）	1,357,709.35	6,829,184.95	
合计	11,474,627.88	50,610,021.54	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期	42.24	公司积极推行降本增效，公司主营产品盈利能力提升。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-40.76	公司出口产品销售回款减少，且本期客户使用票据结算增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,605			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			/	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)								
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		
						股份状态	数量	
北京有研文斯半导体科技有限公司	境内非国有法人	384,750,000	30.84	384,750,000	384,750,000	无	0	
株式会社RS Technologies	境外法人	327,090,400	26.22	327,090,400	327,090,400	无	0	
中国有研科技集团有限公司	国有法人	230,422,500	18.47	0	0	无	0	
福建金元投资有限公司	境内非国有法人	28,215,000	2.26	28,215,000	28,215,000	无	0	
国新风险投资管理（深圳）有限公司—深圳诺河投资合伙企业（有限合伙）	其他	21,112,338	1.69	0	0	无	0	
德州芯利咨询管理中心（有限合伙）	其他	19,339,894	1.55	0	0	无	0	
中信证券投资有限公司	境内非国有法人	17,673,303	1.42	6,054,490	6,054,490	无	0	
德州芯睿咨询管理中心（有限合伙）	其他	13,034,204	1.04	0	0	无	0	
中电科核心技术研发股权投资基金（北京）合伙企业（有限合伙）	其他	8,881,083	0.71	0	0	无	0	
德州芯慧咨询管理中心（有限合伙）	其他	7,011,317	0.56	0	0	无	0	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量				
				股份种类	数量			
中国有研科技集团有限公司	230,422,500			人民币普通股	230,422,500			
国新风险投资管理（深圳）有限公司—深圳诺河投资合伙企业（有限合伙）	21,112,338			人民币普通股	21,112,338			
德州芯利咨询管理中心（有限合伙）	19,339,894			人民币普通股	19,339,894			
德州芯睿咨询管理中心（有限合伙）	13,034,204			人民币普通股	13,034,204			
中信证券投资有限公司	11,618,813			人民币普通股	11,618,813			
中电科核心技术研发股权投资基金（北京）合伙企业（有限合伙）	8,881,083			人民币普通股	8,881,083			
德州芯慧咨询管理中心（有限合伙）	7,011,317			人民币普通股	7,011,317			
北京京国盛投资基金（有限合伙）	6,024,368			人民币普通股	6,024,368			
华润微电子控股有限公司	5,020,307			人民币普通股	5,020,307			
浙江晶盛机电股份有限公司	4,640,307			人民币普通股	4,640,307			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、北京有研艾斯半导体科技有限公司、株式会社RS Technologies实际控制人为方永义。 2、株式会社RS Technologies与福建金元投资有限公司已签署一致行动协议。 3、中信证券之金资子公司中证投资持有公司1.42%的股份，持有研投基金2.74%的出资份额。 4、除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况。							
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无							

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用　□不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中信证券投资有限公司	18,787,990	1.51	766,500	0.06	17,673,303	1.42	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

2024年股票期权激励计划授予情况

2024年9月10日，公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于<有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。2024年9月27日，《关于<有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2024年9月11日和2024年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-039）《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-044）等相关公告。

2024年10月10日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定以2024年10月10日为授予日，向92名激励对象授予1,145.00万份股票期权。具体内容详见公司于2024年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有研半导体硅材料股份公司关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2024-047）。

2024年10月23日，根据《上市公司股权激励管理办法》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，公司已完成2024年股票期权激励计划首次授予登记工作。具体内容详见公司于2024年10月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划首次授予完成登记的公告》（公告编号：2024-048）。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：有研半导体硅材料股份公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,036,570,762.46	1,504,386,200.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,845,693,041.11	1,351,953,493.15
衍生金融资产		
应收票据	74,120,436.06	67,004,744.53
应收账款	238,104,549.14	170,475,938.68
应收款项融资	117,732,359.27	52,353,799.21
预付款项	4,647,703.50	2,405,309.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	774,505.18	400,285.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	185,035,624.33	205,792,594.01
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,662,972.27	14,952,065.98
流动资产合计	3,510,341,953.32	3,369,724,430.82
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	364,625,912.92	385,336,730.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,032,618,651.38	1,014,009,928.15
在建工程	176,676,026.17	123,058,374.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,866,677.14	12,014,349.47
无形资产	81,047,846.87	82,746,540.82
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,126,226.25	3,272,180.43
递延所得税资产	4,041,144.26	5,764,273.64
其他非流动资产	33,405,222.75	17,129,528.79
非流动资产合计	1,736,407,707.74	1,673,331,906.04
资产总计	5,246,749,661.06	5,043,056,336.86
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	96,265,940.01	12,715,301.39
应付账款	105,312,770.66	102,190,351.23
预收款项		
合同负债	263,352.10	245,849.11
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,222,313.90	35,859,380.90
应交税费	11,951,048.90	8,624,792.48
其他应付款	60,670,888.67	64,330,432.31
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,883,470.45	4,309,800.10
其他流动负债		
流动负债合计	306,569,784.69	228,275,907.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,080,862.11	6,791,613.08
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	193,868,167.63	227,426,490.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	196,949,029.74	234,218,103.74
负债合计	503,518,814.43	462,494,011.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,247,621,058.00	1,247,621,058.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,250,982,036.27	2,250,624,106.66
减：库存股	35,935,687.59	
其他综合收益		
专项储备	8,074,213.97	6,238,759.56
盈余公积	25,250,365.27	25,250,365.27
一般风险准备		
未分配利润	800,504,809.54	618,264,075.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,296,496,795.46	4,147,998,364.82
少数股东权益	446,734,051.17	432,563,960.78
所有者权益（或股东权益）合计	4,743,230,846.63	4,580,562,325.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,246,749,661.06	5,043,056,336.86

公司负责人：张果虎　　主管会计工作负责人：杨波　　会计机构负责人：李文彬

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：有研半导体硅材料股份公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	773,102,420.66	790,322,829.26
其中：营业收入	773,102,420.66	790,322,829.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	575,839,139.06	589,016,666.79
其中：营业成本	490,354,379.96	511,002,964.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,010,496.35	5,809,081.63
销售费用	10,614,388.53	10,824,470.73
管理费用	24,816,124.56	22,204,279.88
研发费用	58,800,004.10	65,477,339.29
财务费用	-13,756,254.44	-26,301,469.56
其中：利息费用	273,539.69	34,963.26
利息收入	-16,985,632.74	-20,046,469.94
加：其他收益	46,446,796.96	62,308,710.93
投资收益（损失以"-"号填列）	-4,157,436.05	14,223,326.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-21,020,219.35	-8,424,652.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	13,225,876.71	10,636,105.02
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-1,164,660.37	-400,170.48
资产减值损失（损失以"-"号填列）	1,554,487.89	-2,922,975.93
资产处置收益（损失以"-"号填列）	55,165.92	-1,099.62
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	253,223,512.66	285,150,059.14
加：营业外收入	79,842.22	93,359.91
减：营业外支出	41,059.33	67,542.03
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	253,262,295.55	285,175,877.02
减：所得税费用	30,784,689.17	33,202,794.99
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	222,477,606.38	251,973,082.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	222,477,606.38	251,973,082.03
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	194,681,391.43	222,178,270.35
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	27,796,214.95	29,794,811.68
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	222,477,606.38	251,973,082.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	194,681,391.43	222,178,270.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额	27,796,214.95	29,794,811.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.16	0.18
（二）稀释每股收益（元/股）	0.16	0.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张果虎　　主管会计工作负责人：杨波　　会计机构负责人：李文彬

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：有研半导体硅材料股份公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	514,743,901.43	726,451,400.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	12,983,439.89	12,538,146.66
收到其他与经营活动有关的现金	46,102,091.69	63,267,325.36
经营活动现金流入小计	573,829,433.01	802,256,872.50
购买商品、接受劳务支付的现金	265,352,007.54	391,884,525.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	113,729,344.93	104,708,914.19
支付的各项税费	33,326,402.02	38,268,823.99
支付其他与经营活动有关的现金	17,980,982.20	25,270,476.31
经营活动现金流出小计	430,388,736.69	560,132,739.69
经营活动产生的现金流量净额	143,440,696.32	242,124,132.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,250,000,000.00	4,313,000,000.00
取得投资收益收到的现金	26,349,112.05	29,755,778.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,333.98	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	534,200.02	1,069,504.78
投资活动现金流入小计	5,276,886,646.05	4,343,825,283.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,939,978.01	77,044,591.76
投资支付的现金	5,740,000,000.00	6,145,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,026,222.36	
投资活动现金流出小计	5,901,966,200.37	6,222,044,591.76
投资活动产生的现金流量净额	-625,079,554.32	-1,878,219,308.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,181,388.80	1,787,471.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,181,388.80	1,787,471.40
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,181,388.80	1,787,471.40
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,416,242.59	94,744,894.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,975,400.00	37,550,513.11
支付其他与筹资活动有关的现金	39,462,976.38	8,557,445.49
筹资活动现金流出小计	66,879,218.97	103,302,340.48
筹资活动产生的现金流量净额	-65,697,830.17	-101,514,869.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,185,951.03	4,283,520.36
五、现金及现金等价物净增加额	-549,522,639.20	-1,733,326,524.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,477,120,831.11	2,342,613,183.72
六、期末现金及现金等价物余额	927,598,191.91	609,286,659.64

公司负责人：张果虎　　主管会计工作负责人：杨波　　会计机构负责人：李文彬

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2024年10月28日

证券代码：688432　　证券简称：有研硅　　公告编号：2024-049

有研半导体硅材料股份公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议于2024年10月28日以通讯的方式召开。本次会议通知于2024年10月22日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王慧主持，公司董事会秘书杨波列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

监事会认为：根据《公司法》、上海证券交易所相关规范性文件要求及《公司章程》的有关规定，公司编制了2024年第三季度报告。报告的内容与格式符合相关规定，客观、真实、公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项。公司2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《有研半导体硅材料股份公司2024年第三季度报告》的内容。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研半导体硅材料股份公司2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《有研半导体硅材料股份公司募集资金管理制度》的规定，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意公司及子公司使用闲置募集资金（含超募资金）不超过80,000万元（含本数）进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研半导体硅材料股份公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-050）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司监事会

2024年10月30日

证券代码：688432　　证券简称：有研硅　　公告编号：2024-050

有研半导体硅材料股份公司 关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"或"有研硅"）于2024年10月28日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用不超过人民币80,000万元（含超募资金）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

现将公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2047号），有研半导体硅材料股份公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）18,714.3158万股，每股发行价格为9.91元，募集资金总额为人民币185,458.87万元，扣除不含税发行费用，实际募集资金净额为人民币166,396.72万元，以上募集资金毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月7日出具《验资报告》（毕马威华振验字第2201588号），对公司首次公开发行股票新增注册资本及实收资本的情况进行了验证。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次首次公开发行股票募集资金投资项目情况计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金拟投资金额	实施主体
1	集成电路用8英寸硅片扩产项目	38,482.43	38,482.43	山东有研半导体材料有限公司
2	集成电路刻蚀设备用硅材料项目	35,734.76	35,734.76	山东有研半导体材料有限公司
3	补充研发与营运资金	25,782.81	25,782.81	有研硅
合计		100,000.00	100,000.00	

目前，公司正按照募集资金使用情况，有序推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）投资额度及期限

公司计划使用不超过人民币80,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（四）实施方式

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

（六）现金管理收益的分配

公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司及子公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的理财产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《有研半导体硅材料股份公司募集资金管理制度》的规定，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意公司及子公司使用闲置募集资金（含超募资金）不超过80,000万元（含本数）进行现金管理。

（二）保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：有研硅及其子公司山东有研半导体材料有限公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。

综上，保荐机构对有研硅及其子公司实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议